



**大会共主席**  
Jan Van der Spiegel  
Zhiliang Hong  
Yong Lian  
Ting-Ao Tang  
Yi Shi  
Hongxia Liu

**顾问委员会共主席**  
Chenming Hu  
Richard.M.M.Chen  
Hiroshi Iwai  
Cor Claeys  
Qianling Zhang

**程序委员会共主席**  
Fan Ye  
Xinran Wang  
Francois Rivet  
Haruo Kobayashi  
Hidetoshi Onodera  
Jyi-Tsong Lin  
Yi Zhao

**组织委员会共主席**  
Mengqi Zhou  
Huihua Yu

**宣传主席**  
Rui Yin  
Wei Xu  
Jiting Sheng

**秘书长**  
Fan Ye

<http://www.asicon.org>

## 征稿通知

### 第15届国际专用集成电路会议

The IEEE 15<sup>th</sup> International Conference on ASIC

2023年10月24日—27日, 南京, 中国

**主办单位** 国际电机与电子工程师协会北京分会  
(IEEE Beijing Section)  
**承办单位** 复旦大学 南京大学  
**支持单位** IEEE CASS IEEE SSCS 上海分会  
IEEE EDS 上海分会 IET 上海分会  
中国电子学会 (CIE)

第十五届IEEE国际专用集成电路会议(ASICON 2023)将于**2023年10月24日—27日**在**江苏南京白金汉爵大酒店**举行。这次会议旨在为VLSI电路设计者、ASIC用户、系统集成工程师, IC制造厂商、工艺和器件工程师以及CAD/CAE工具开发者提供一个国际论坛, 介绍他们在各自领域获得的最新进步和研发成果。四天的会议将汇集中外著名专家关于VLSI电路、器件、工艺设计与制造等技术最新发展的主题演讲、论文报告以及资深专家的讲课。大会将评选出优秀学生与青年学者论文, 并安排EDA工具、制造厂商、IC工艺、器件测试仪器以及最新ASIC产品的展示。会议论文集将具有IEEE的统一书号, **录用并作 presentation(包括 Oral 及 Poster) 的论文都可被 IEEE Xplore和EI检索。**

#### 征稿范围及要求

征稿主要包括但不局限于以下内容:

##### I. 集成电路设计技术

- [1] 模拟IC
- [2] 数字IC
- [3] 无线、有线通信和光通信IC
- [4] 存储器技术
- [5] 传感器、图像处理与医疗电子
- [6] FPGA和DSP
- [7] 特殊应用IC
- [8] 测试、可靠性、容错性

##### II. CAD技术

- [9] 电路仿真、综合、验证和物理设计
- [10] 支持系统设计、可制造性设计和可测性设计的CAD技术

##### III. 新工艺, 新技术, 新器件及其应用

- [11] MEMS技术
- [12] 纳米电子学和千兆集成系统
- [13] 新器件: 异质结器件、FinFET、CNT、MTJ器件、3-D集成、光电子器件、功率器件、化合物半导体器件等
- [14] 先进互连技术、High K/金属栅技术及其它VLSI新工艺和技术
- [15] 工艺建模与仿真

##### IV. 其它VLSI设计与器件相关议题

- [16] 其它与VLSI设计相关的课题
- [17] 其它与VLSI器件相关的课题

## 特邀大会报告

### Session K1-1: Technology Innovations at the heart of Engineering Humanitarian Solutions

时间: 9:00-9:45, 2023年10月25日, 星期三

报告人: Dr. Rakesh Kumar

IEEE Life Fellow, IEEE TA Hall of Honor Chair, IEEE Roadmaps Chair,  
President, Technology Connexions, Inc, USA

### Session K1-2: Let the Plants Do the Talking: Smart Agriculture by the Messages Received from Plants and Soil

时间: 9:45-10:30, 2023年10月25日, 星期三

报告人: Prof. Danilo Demarchi

Politecnico di Torino, Italy

### Session K2-1 Oxide Thin-Film Transistors and Integrations

时间: 10:45-11:30, 2023年10月25日, 星期三

报告人: Prof. Aimin Song

University of Manchester, UK

### Session K2-2 Efficiency, Resilience, and Versatility in Memristive Neuromorphic Systems for AI on the Edge

时间: 11:30-12:15, 2023年10月25日, 星期三

报告人: Prof. Gert Cauwenberg

University of California, San Diego, USA

### Session K3-1 RF Acoustic Wave Devices in Mobile Communications --- Aliens from Jupiter

时间: 8:30-9:15, 2023年10月26日, 星期四

报告人: Prof. Ken-ya Hashimoto, IEEE Fellow

University of Electronic Science and Technology of China

### Session K3-2 The back-gate of UTBB FDSOI transistor : a magic knob for analog and mixed cells

时间: 9:15-10:00, 2023年10月26日, 星期四

报告人: Prof. Gilles Jacquemod

Université Côte d'Azur, France

### Session K4-1 Sub-Terahertz Communication and Its Future Towards 6G

时间: 8:30-9:15, 2023年10月27日, 星期五

报告人: Prof. Minoru Fujishima

Hiroshima University, Japan

### Session K4-2 Terahertz-chip-scale systems for Intelligent Sensing and 6G Communication

时间: 9:15-10:00, 2023年10月27日, 星期五

报告人: Prof. Kaushik Sengupta

Princeton University, USA

## 应征稿件注意事项

应征论文须以英文提交, 页数**不超过4页** (包括图表、参考文献等), 双栏, 10pt 字体。具体说明请参考网站上的“论文模板”, 请按照最终出版要求投递。所有应征论文必须通过网站投递。申请参加优秀学生与青年学者论文评选请注明。论文准备和提交的详细说明可参见会议网站。欢迎对 **Tutorial** 和 **Panel Discussion** 的题目提出建议。

联系人: 虞惠华 (会务)

叶凡 (论文)

Email: [asicon\\_org@fudan.edu.cn](mailto:asicon_org@fudan.edu.cn)

[fanye@fudan.edu.cn](mailto:fanye@fudan.edu.cn)

会议网站:

<http://www.asicon.org>

文章投递截稿日期 2023年6月30日

论文录用通知日期 2023年8月15日